



MICRO POWDERS

5N PLUS

# 次世代 合金粉・はんだ粉



低融点～高融点  
に対応



高精度な  
粒度コントロール

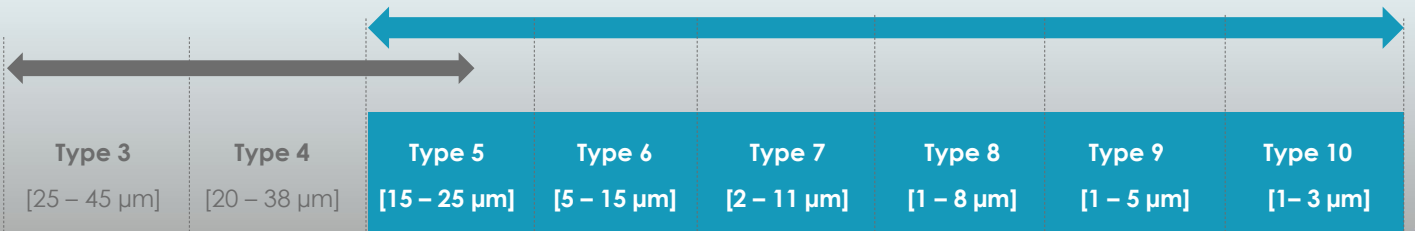
5N PLUS MICRO POWDERS は  
独自のアトマイズ技術により  
次世代 合金粉・はんだ粉を  
ご提供いたします。  
(TYPE 5～TYPE10)

## 製品特徴

- 低酸素量
- 高純度
- 球状粒子
- 粒径：TYPE 5 ～ TYPE 10
- スクリーン印刷 及び 軽薄短小化する電子部品への  
各種ディスペンサ・ジェットディスペンサに最適

従来製法\*

5N Plus 独自製法



\*従来製法：ディスクアトマイズ法・超音波法

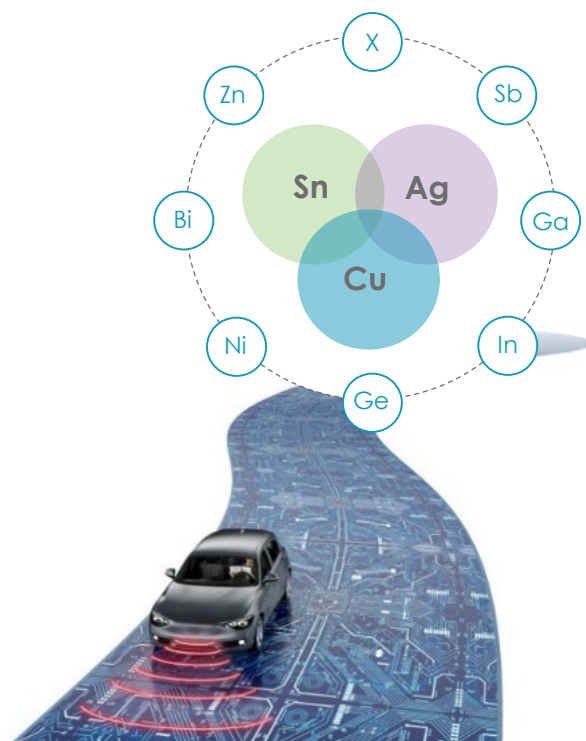
## はんだ粉

組成, wt.%	凝固点(°C)
Sn42Bi58	138*
Sn42Bi57Ag1	139*
Sn96.5-Ag3.0-Cu0.5	217-220
Sn95.5-Ag4.0-Cu0.5	217-220
Sn99.3-Cu0.7	227*
Sn95-Ag5	221-245
Sn	232
Sn95-Sb5	237-240
Sn90-Sb10	243-257
Bi97.5Ag2.5	262-267
Bi	271

## 低融点 合金粉

組成, wt.%	凝固点 (°C)
Bi32.5-Sn16.5-In51	61*
Bi33.7-In66.3	72*
Bi57-Sn17-In26	78*
Bi67-In33	109*
Sn50-In50	118-120
Bi58-Sn42	138*
Bi57-Sn42-Ag1	139*
In97-Ag3	145*
Bi50-Sn50	138-154
Bi40-Sn60	138-170
In	157
Sn91-Zn9	199*

\* 共晶 又は 近共晶 合金粉



## 高融点 合金粉

組成, wt.%	凝固点 (°C)
Sn80-Cu20	420-520
Cu65-Sn35	725-750
Ag72-Cu28	779*
Ag alloys	< 982
Cu90-Sn10	860-1010
Cu	1085

## 低α 合金粉

電子・半導体 向け 低α粉をラインナップ。  
 粒径: TYPE5~TYPE8 (1~25μm) の様々な  
 鉛フリー合金を取り揃えております。

低α タイプ <0.002 c/h/cm<sup>2</sup>

超低α タイプ <0.001 c/h/cm<sup>2</sup>

国内輸入代理店

森村商事株式会社

電子材料事業部 電子材料部

問い合わせ :03-3432-3562

5N Plus Micro Powders

4385 Garand Street, Montreal, QC, Canada H4R 2B4

+1-514-856-0644 | ext. 2288

sales.micropowders@5nplus.com

[www.5nplus.com](http://www.5nplus.com)



MICRO POWDERS

# 초미세 분말을 가능케하는 기술



5N 플러스는 1~ 25  $\mu\text{m}$ 까지의 초미세 땀납 분말 생산에 특히 효과적인 독점적인 원자화 기술을 개발했습니다.

이 기술 개발의 결과로 나오는 제품은:

- 산소 함량이 낮고
- 고순도이며
- 구형 입자이고
- 크기는 Type 5 ~ Type 10이며
- 스크린 프린팅, 디스펜싱 및 제트 프린팅에 이상적임

## 5N 플러스의 기술

Type 5	Type 6	Type 7	Type 8	Type 9	Type 10
[15 - 25 $\mu\text{m}$ ]	[5 - 15 $\mu\text{m}$ ]	[2 - 11 $\mu\text{m}$ ]	[1 - 8 $\mu\text{m}$ ]	[1 - 5 $\mu\text{m}$ ]	[1 - 3 $\mu\text{m}$ ]







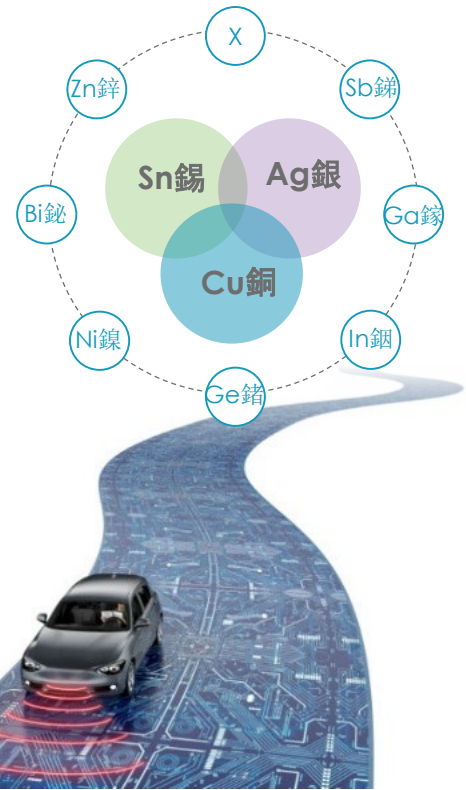
## 焊錫粉

組成成分, 重量%	固化溫度範圍(°C)
Sn42Bi58	138*
Sn42Bi57Ag1	139*
Sn96.5-Ag3.0-Cu0.5	217-220
Sn95.5-Ag4.0-Cu0.5	217-220
Sn99.3-Cu0.7	227*
Sn95-Ag5	221-245
Sn	232
Sn95-Sb5	237-240
Sn90-Sb10	243-257
Bi97.5Ag2.5	262-267
Bi	271

## 低熔點合金

組成成分, 重量%	固化溫度範圍(°C)
Bi32.5-Sn16.5-In51	61*
Bi33.7-In66.3	72*
Bi57-Sn17-In26	78*
Bi67-In33	109*
Sn50-In50	118-120
Bi58-Sn42	138*
Bi57-Sn42-Ag1	139*
In97-Ag3	145*
Bi50-Sn50	138-154
Bi40-Sn60	138-170
In	157
Sn91-Zn9	199*

\* 共晶或近共晶合金



## 高溫粉末

組成成分, 重量%	固化溫度範圍(°C)
Sn80-Cu20	227-520
Cu65-Sn35	725-750
Ag72-Cu28	779*
Ag alloys	< 982
Cu90-Sn10	860-1010
Cu	1085

## 低Alpha粉末

低 alpha 粉末現已成為電子市場產品系列中不可或缺的一部分, 粒徑尺寸包括各種無鉛合金中的Type 5到Type 8

ULA <0.002 c/h/cm<sup>2</sup>  
SULA <0.001 c/h/cm<sup>2</sup>